メカニックス系工学専攻

CAE分野

設計システム研究室

教授

落合 芳博

Design System Lab.

Prof.

Yoshihiro Ochiai

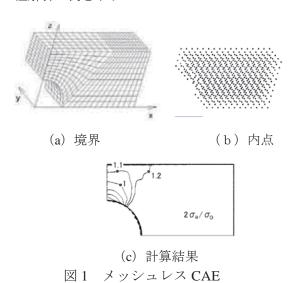
#### キーワード

CAE, メッシュレス法, 自由曲面, 補間, 数値積分法, BEM, Meshless Method, Interpolation, Numerical Integral

## 研究内容

### [1] メッシュレス CAE (計算力学)

機械構造物の応力解析において有限要素法が盛ん に利用されている.しかし、CAD と異なり有限要素 法解析においては, 形状を定義するだけでなく, 要 素分割が必要である. 高度な自動要素分割プログラ ムの開発も盛んに行われているが、三次元の要素分 割には、かなりの CPU Time を要するし、大変形解析 の場合, リメッシュの問題がある. また, 要素分割 により計算値が異なる場合がある. そこで, 要素分 割を使用しないメッシュレス解法が研究されている. 一方, 境界要素法は境界の要素分割のみで解析が行 えるが、非線形解析においては、セルと呼ばれるメ ッシュ分割が必要になる. 本研究では, 熱弾塑性解 析などの非線形解析においてもメッシュレスで解析 する方法を開発した. 本解法を三重相反 BEM と名付 けている. 図1に内点を使用したメッシュレス弾塑 性解析の例を示す.



#### [2] 自由曲面の創成法

CAD において自由曲面を作成する場合,主としてスプライン関数を使用する.しかし,スプライン関数を使用する方法では,点を碁盤目状に指定しなければならない.形状によっては,碁盤目状に点列を指定するために,長時間必要な場合がある.一方,

小さなパッチで形状を与える方法もあるが、滑らかさが劣る.本研究では、任意の点群から自由曲面を 作成する.本理論では多重調和関数を使用した補間 法を活用して滑らかな面を得ることができる.この 理論を用いてモーフィングも行える.

# [3] 多次元数值積分法

任意領域の多次元数値積分を多重調和関数を用いて行う. その際,積分点は任意位置でよい.被積分関数を積分方程式を用いて補間した後,次元を一次元下げて数値積分を行う. なお,特異点や偏微分項を含む多次元数値積分も行うことができる.

### 最近の業績

- [1] 落合芳博, 西道隆征, 鬼塚宗一朗, 三重相反境界 要素法による非定常熱弾塑性解析 日本機械学会論文集 A編, Vol.77, No.778, pp.9 25-934 (2011)
- [2] 落合芳博, 阪上智浩, 三重相反境界要素法による 三次元非定常熱応力解析, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.77, No.778, pp.935-946(2011)
- [3] 落合芳博, Meshless Unsteady Thermo
  -Elastoplastic Analysis by Triple-Reciprocity
  Boundary Element Method, CMES, Vol.79, No.2,
  pp.83-101 (2011)
- [4] Yoshihiro OCHIAI and Tomohiro Shimizu, Deformation Analysis of Thin Plate with Distributed Load by Triple-Reciprocity Boundary Element Method, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.36, No.5, pp.772-778, (2012)
- [5] Yoshihiro OCHIAI, Vladimir Sladek, Jan Sladek, Three-Dimensional Unsteady Thermal Stress Analysis by Triple-Reciprocity Boundary Element Method, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.37, No.2, pp.116-127, (2013-2)
- [6] 落合芳博, V. Sladek, J. Sladek, Axial Symmetric Stationary Heat Conduction Analysis of Functional Gradient Materials by Triple-Reciprocity Boundary Element Method, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.37, No.2, pp.336-347, (2013-2)
- 科学研究費, 基盤研究(C), (平成 22-25 年度)